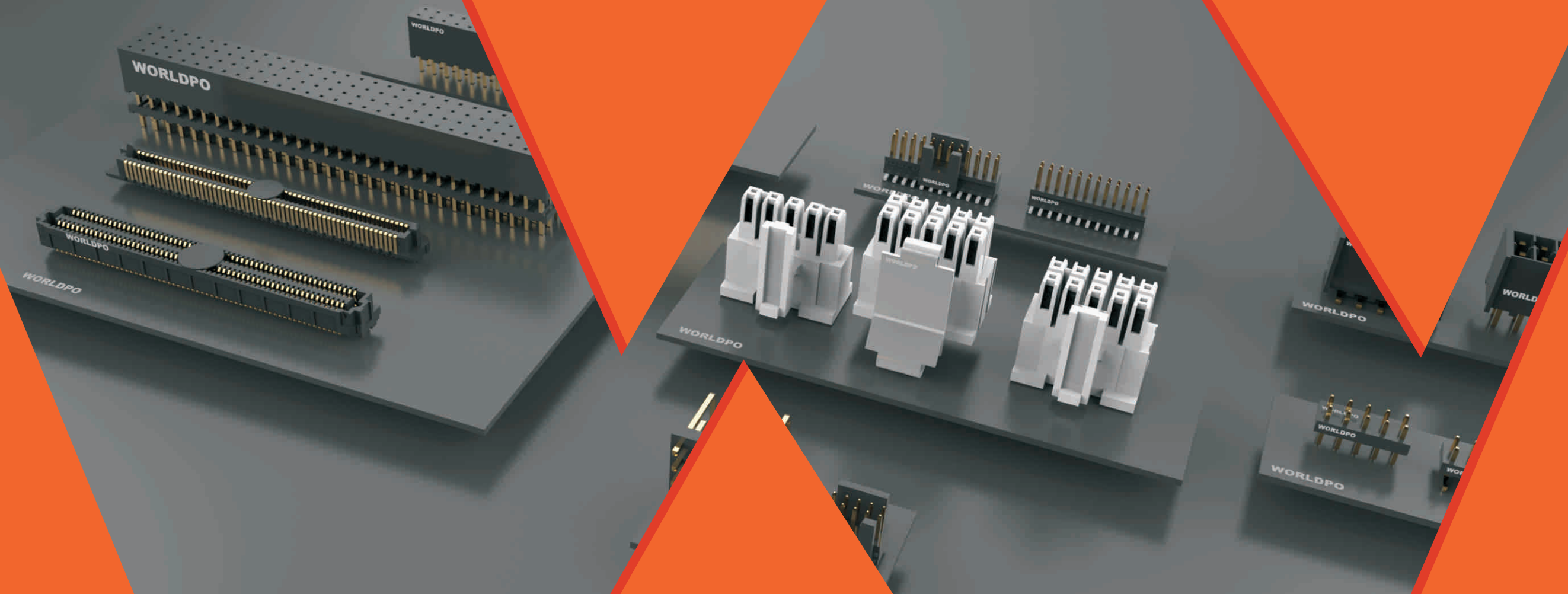


WORLDPO



公司介绍

WORLDPO

沃德披欧连接器

深圳市沃德披欧精密器件有限公司创立于2022年，是专门从事连接器的设计和研发公司。公司致力于研发高品质、高可靠性的连接器，并以替代进口连接器为主，以降低成本50%以上的价格，做中国品牌连接器。

公司拥有一批经验丰富、技术过硬的研发团队，他们熟悉各种连接器的设计和制造技术，掌握先进的优化工艺，能够持续推出具有创新性并且质量卓越的产品，得到广大客户的好评和信任。

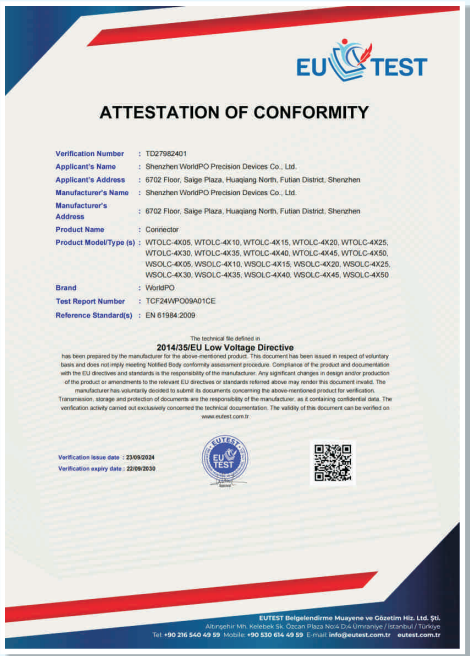
沃德披欧精密器件有限公司认为质量是企业发展的源泉，注重产品研发、生产和服务的全方位质量管理。公司通过国际ISO9001质量管理体系认证，加强对每个环节的质量控制和监督。我们有完备的质量保证体系和售后服务体系，以确保用户的使用无忧。

沃德披欧精密器件有限公司主要产品涵盖边角型连接器、线对线连接器、传输连接器、板对板连接器、电源连接器、排母连接器等系列产品。产品广泛应用于电子、仪表、自动化、计算机、通信、安防等领域，深受国内外客户的青睐。

未来，沃德披欧精密器件有限公司将持续致力于产品的创新和优化，为客户提供更优质的连接器产品。同时，在全球化发展的大背景下，公司将加强技术和人才的引进和培养，拓宽国际市场，加速中国制造向中国创造的转变，为中国品牌连接器走向世界打下坚实的基础。



公司资质



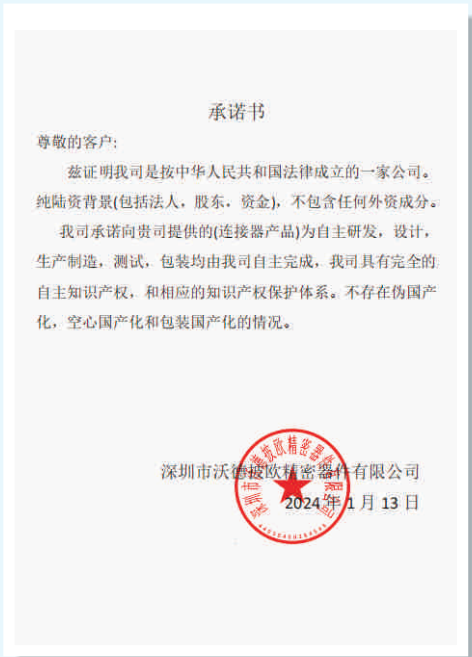
ce认证证书



ISO认证



连接器 FCC证书



国产化证明



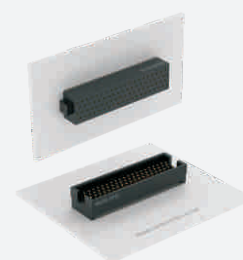
合作客户



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY



Mercedes-Benz



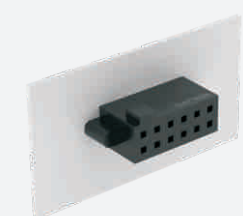
WSOLC / WTOLC系列
1.27mm 间距
四排：20~200pin
配对合高：6.35~12.00mm

01-02



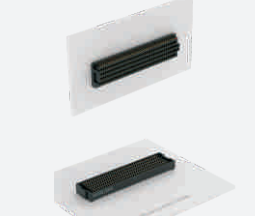
WTFM系列
1.27mm 间距
1、2排：03~100pin
配对合高：
贴片：6.35~11.81mm
直插：5.97~11.43mm

03-04



WSFM系列
1.27mm 间距
1、2排：03~100pin
配对合高：
贴片：6.35~11.81mm
直插：5.97~11.43mm

05-06



WSEAM / WSEAF系列
1.27mm 间距
4、5、6、8、10、14排：
40~700pin
配对合高：7.00~18.5mm

07-08



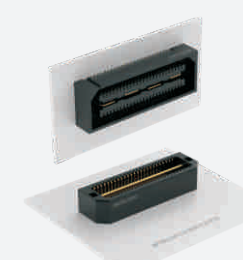
WQTH / WQSH系列
0.5mm 间距
两排：40~180pin
配对合高：5.00~25.00mm

09-10



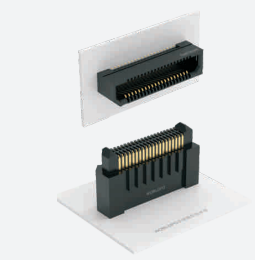
WQTE / WQSE系列
0.80mm 间距
两排：28~120pin
配对合高：5.00~25.00mm

11-12



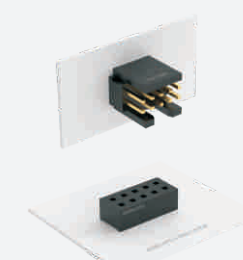
WQTS / WQSS系列
0.635mm 间距
两排：50~150pin
配对合高：5.00~8.00mm

13-14



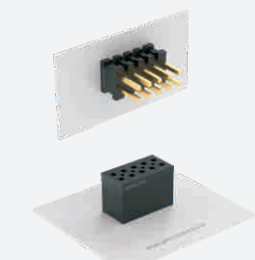
WERM8 / WERF8系列
0.80mm 间距
两排：10~200pin
配对合高：7.00~18.00mm

15-16



WFTSH-SM(贴片)
1.27mm 间距
两排：4~100pin

17-18



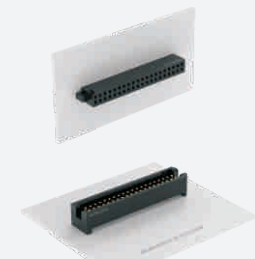
WFTSH-TH(直插)
1.27mm 间距
两排：4~100pin

19-20



WLSHM系列
0.50mm 间距
两排：10~100pin
配对合高：5.00~12.00mm

21-22



WSFC / WTFC系列
1.27mm 间距
两排：6~100pin
配对合高：
贴片：6.35~11.81mm
直插：5.97~11.43mm

23-24

1.27mm 间距 WSOLC / WTOLC系列

四排：20~200pin 配对合高：6.35~12.00mm

WSOLC 系列

WTOLC 系列

LC

A

LC

A

技术参数

绝缘体材料：黑色液晶聚合物
触点材料：磷铜
电镀：在50μ" (1.27μm)的镍上镀金
额定电流：2.54A每针@周围环境80℃
工作温度范围：-55℃至+125℃
可无铅焊接：是
SMT引线共面度(WTOLC)：
(0,10 mm) .004" 最大 (05-30)
(0,15 mm) .006" 最大 (35-50)

触点电阻：10 mΩ
插入深度：
(1.68 mm) .066"至(3,61 mm) .142"与(0,38 mm) .015"擦接
插入力：(仅限单触点) 平均为 2.0 oz(0,56 N)
正交力：平均为 75 克(0,74 N)
拔出力：(仅限单触点) 平均为 1.5 oz(0,42 N)
最大配接次数：100+
SMT 引线共面性(WSOLC)：
(0,10 mm) .004"最大(05-35)
(0,15 mm) .006" 最大(40-50)

注：某些尺寸、式样和选项为非标准型，不可退换。

型号命名规则

WTOLC	4X	每排引脚数	引线式样	电镀选项	Q	选项
		05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50	从图表中指定引线式样	F =接线柱镀金膜，在焊尾上镀金膜 L =触点上镀 10μ" (0,25 μm) 的金，焊尾镀金膜		A =定位针 (不提供 LC) LC =锁定夹(不提供A) (需要手动放置) K =(9,00 mm) .354"直径的聚酰亚胺膜取放垫 TR =卷带封装

位置数 x (1,27) .050 + (2,54) .100
位置数 x (1,27) .050 + (0,76) .030
(6,86) .270
(1,27) .050 式样
(0,635) .025 式样
式样 H02
式样 H12、H22、H32

引线式样	A	配接高度
H02	(5,59) .220	(6,35) .250
H12	(7,24) .285	(8,00) .315
H22	(9,25) .364	(10,00) .394
H32	(11,23) .442	(12,00) .472

A 选项
LC 选项

WSOLC	4X	每排引脚数	H02	电镀选项	Q	选项
		05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50		F =触点镀金膜，焊尾镀金 L =触点镀 10μ" (0,25 μm) 的金，焊尾镀金		A =定位针 (不提供 LC) LC =锁定夹(不提供A) (需要手动放置) K =(7,00 mm) .276"直径的聚酰亚胺膜取放垫 P =取放垫 TR =卷带封装

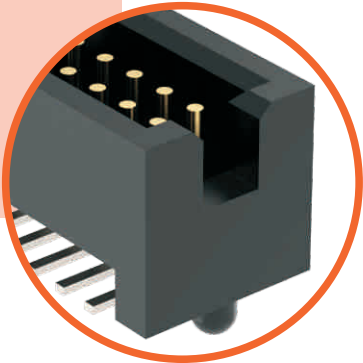
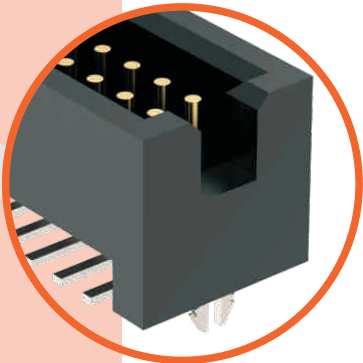
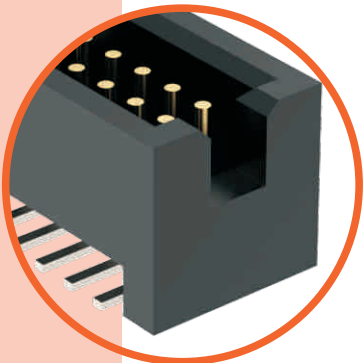
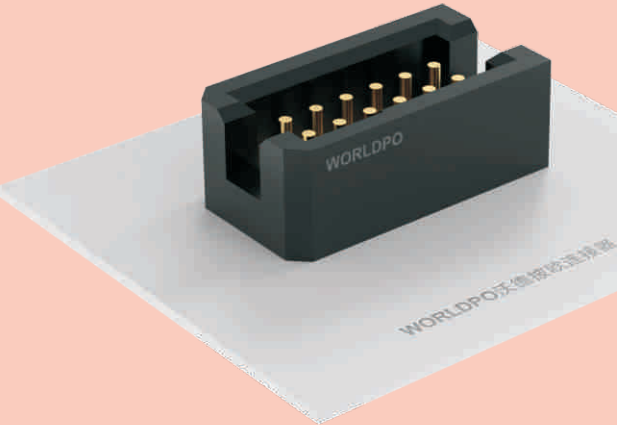
(2,54) .100
(6,35) .250
(0,635) .025
(1,27) .050 式样
(1,27) .050 式样
(0,76) .030
(1,40) .055
(0,89) .035
(1,42) .056
A 选项
LC 选项
P 选项

位置数 x (1,27) .050 + (0,51) .020
(4,06) .160
(4,62) .182
(7,11) .280
(1,02) .040 式样 (2)
(2,54) .100
(0,25) .010

1.27mm 间距 WTFM系列

1、2排：03~100pin
配对合高：贴片：6.35~11.81mm
直插：5.97~11.43mm

WTFM系列



技术参数

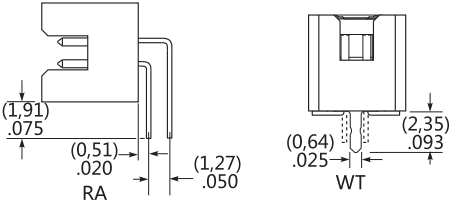
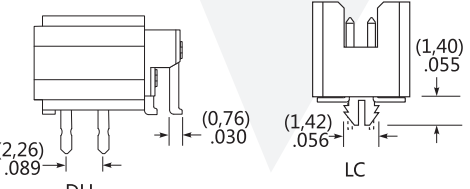
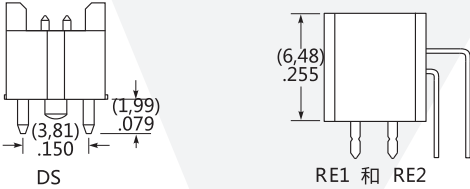
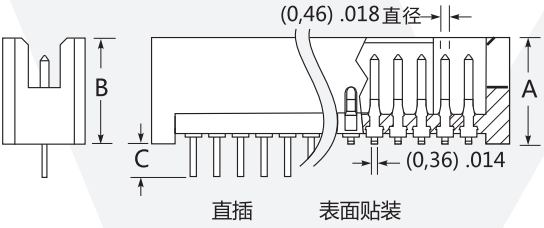
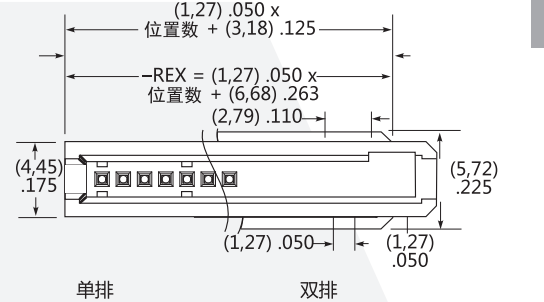
绝缘体材料：黑色液晶聚合物
端子材料：磷铜
电镀：在50μ" (1.27μm)的镍上镀金或锡
额定电压：250 VAC(与 WSFM 配接时)
工作温度范围：-55℃至+125℃
可无铅焊接：是
SMT引线共面度：
最大(0,10 mm) .004" (05-25)
最大(0,15 mm) .006" (30-50)

额定电流(每个触点)	
环境温度	WTFM/WSFM
20℃	5A
40℃	4.5A
60℃	3.9A
95℃	2.6A
6 个通电位置(2x3)	

注：某些尺寸、式样和选项为非标准型，不可退换。

型号命名规则

WTFM	2	每排引脚数	引线式样	电镀选项	排选项	选项
1, 2 排	03, 04, 06, 08 (仅限H01和H02) 05, 07, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 (标准尺寸)	从图表 中指定 引线式样	L =接线柱上 镀15μ"(0,25 μm)的金, 焊尾镀雾锡 S =接线柱上镀 30μ"的金, 焊尾镀雾锡	DH =双排水平(仅 WTFM引线 式样H02) (仅05至50位 置)(WT标配; 仅提供TR 选项)	仅指定 RA, RE1, RE2 RA =弯角 (仅引线式样 H01) RE1 =用于 (1,58 mm) .062" PCB 的加高 弯角(需要 WTFM引线 式样 H01、 D排和WT) RE2 =用于(2,36 mm) .093" PCB的加高 弯角(需要 WTFM 引线 式样H01、D 排和WT)	仅指定 A、LC DS或 WT (不适用于RA、 RE1、RE2) A =定位针 LC =锁定夹 DS =用于 (1,60 mm) .062" PCB的双重拧 紧(仅05至40 个位置)(引线 式样仅H01、 H02和H03) (需要D排选项 (不适用于 WSFML) (配接WTFM DS 选项) WT =焊片 (仅WTFM引 线式样H01 和H02) (DH标配) (仅配接 WSFSS/ WSFSD SR和DR 选项)(仅 05、 07、10、15、 20、25、30、 35、40、45、 50位置) K =聚酰亚胺薄 膜拾取贴装 垫 P =塑料拾取贴 装垫 TR =卷带封装



引线式样	A
H02	(5.72).225
H12	(7.49).295
H22	(9.27).365
H32	(11.18).440

引线式样	B	C
H01	(5.59).220	(1.97).078
H03	(5.59).220	(2.77).109
H11	(7.37).290	(1.97).078
H13	(7.37).290	(2.77).109
H21	(9.14).360	(1.97).078
H23	(9.14).360	(2.77).109
H31	(11.05).435	(1.97).078

配接高度					
引线式样(SMT)		配接高度	引线式样(TH)		配接高度
WTFM	WSFM		WTFM	WSFM	
H02	H02	(6.35).250	H01	H01	(5.97).235
H12		(8.13).320	H03		(5.97).235
H22		(9.91).390	H11		(7.75).305
H32		(11.81).465	H13		(7.75).305
			H21		(9.53).375
			H23		(9.53).375
			H31		(11.43).450

1.27mm 间距 WSFM系列

1、2排：03~100pin
配对合高：贴片：6.35~11.81mm
直插：5.97~11.43mm

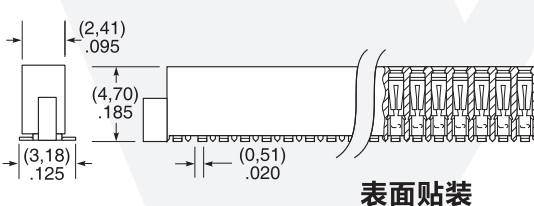
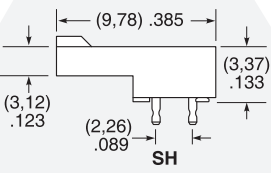
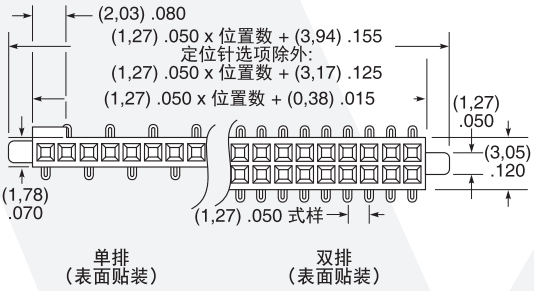
WSFM系列

型号命名规则

WSFM	2	每排引脚数	引线式样	电镀选项	排选项	选项
1, 2 排	03, 04, 06, 08 (仅限WSFM) 05, 07, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 (标准尺寸)	(表面贴装) H02 =触点(镀铜) HL2 =低插入力 触点(镀铜) HT2 =LITE触点 (磷青铜)	(穿孔) H01, H03 =触点(镀铜) HL1, HL3 =低插入力 触点(镀铜) HT1 =LITE触点 (磷青铜)	L =触点上镀10μ" 的金, 焊尾镀 雾锡 S =触点上镀30μ" 的金, 焊尾镀 雾锡	D SH =单排水平 (仅05至30个 位置) (仅WSFM) (仅引线式样 H02) DH =双排水平 (仅05至30个 位置) (仅WSFM) (仅引线式样 H02)	仅指定 A、LC 或 DS (不适用于DH、 SH) A =定位针 LC =锁定夹 DS =用于 (1,60 mm) .062" PCB的双重拧 紧(仅05至 40个位置) (引线式样仅 H01、H02和 H03)(需要D 排选项)(不适 用于WSFML) (配接WTFM DS 选项) K =聚酰亚胺薄 膜拾取贴装垫 (不适用于 DH、SH) P =塑料拾取贴 装垫 (不适用于 DH、SH) 最后指定 TR (引线式样仅 H02、HL2、 HT2) TR =卷带封装

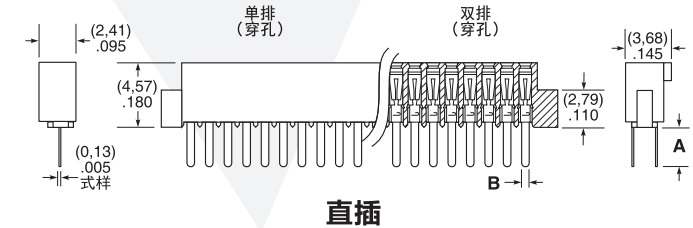
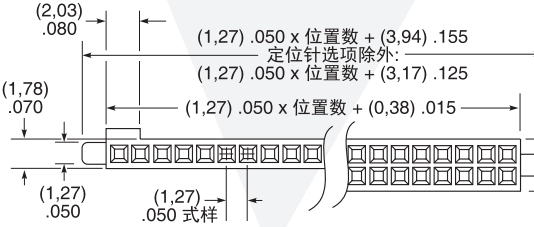
Technical drawing of a single-pin connector. Dimensions include: (2,03) .080 for pin pitch, (1,27) .050 x 位置数 + (3,94) .155 for total length (excluding pin), (1,27) .050 x 位置数 + (3,17) .125 for length to the last pin, (1,27) .050 x 位置数 + (0,38) .015 for length to the first pin, (1,27) .050 式样 for pin length, (1,27) .050 for pin length, (3,05) .120 for pin length, (3,12) .123 for pin length, (2,26) for pin length, (9,78) .385 for pin length, (3,37) .133 for pin length.

Technical drawing of a double-pin connector. Dimensions include: (2,03) .080 for pin pitch, (1,27) .050 x 位置数 + (3,94) .155 for total length (excluding pin), (1,27) .050 x 位置数 + (3,17) .125 for length to the last pin, (1,27) .050 x 位置数 + (0,38) .015 for length to the first pin, (1,27) .050 式样 for pin length, (1,27) .050 for pin length, (3,05) .120 for pin length, (3,12) .123 for pin length, (2,26) for pin length, (9,78) .385 for pin length, (3,37) .133 for pin length.

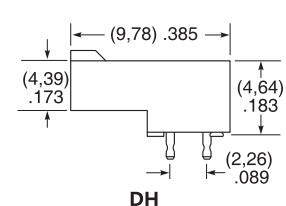
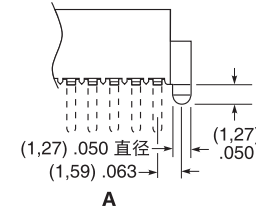
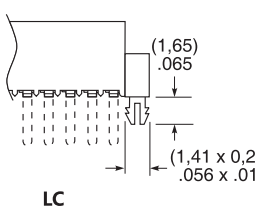
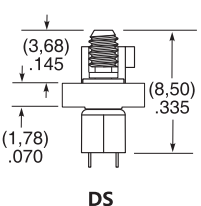


表面贴装

引线式样	A	B
H01, HL1, HT1	(3.05).120	(0.51).020
H02	(1.91).075	(0.41).016



直插



技术参数

绝缘体材料：黑色液晶聚合物
触点材料：镀铜、LITE=磷铜
电镀：在50μ" (1.27μm)的镍上镀金或锡
额定电压：250 VAC(与 WTFM 配接时)
工作温度范围：-55℃至+125℃
触点电阻：15 mΩ
插入深度：
(3,05 mm) .120"至(4,06 mm) .160"
擦接距离：(0,38 mm) .015"
正交力：
标准 = 平均 132 g (1,29 N)
LIF = 平均 90 g (0,88 N)

插入力 (WSFM)：(仅单触点)
标准 = 平均 2.5 oz (0,69 N)
LITE = 平均 2.0 oz (0,56 N)
LIF = 平均 1.4 oz (0,39 N)
拔出力 (WSFM)：(仅单触点)
标准 = 平均 2.0 oz (0,56 N)
LITE = 平均 1.5 oz (0,42 N)
LIF = 平均 1.0 oz (0,28 N)
最大插拔次数：10,000 次
(具有 30μ" (0,76 μm)镀金)
可无铅焊接：是

注：某些尺寸、式样和选项为非标准型，不可退换。

SMT引线共面度：
最大(0,10 mm) .004"(05-25)
最大(0,15 mm) .006"(30-50)

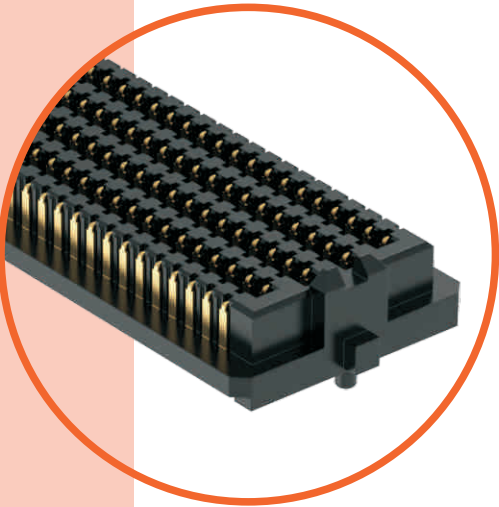
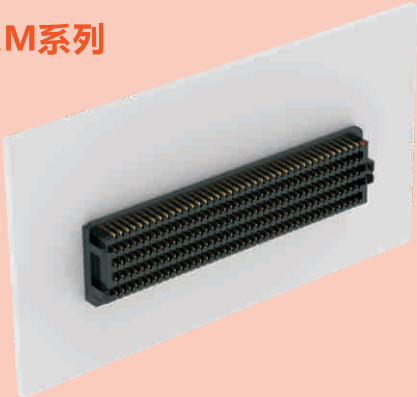
额定电流(每个触点)	
环境温度	WTFM/WSFM
20℃	5A
40℃	4.5A
60℃	3.9A
95℃	2.6A
6 个通电位置(2x3)	

1.27mm 间距 WSEAM / WSEAF系列

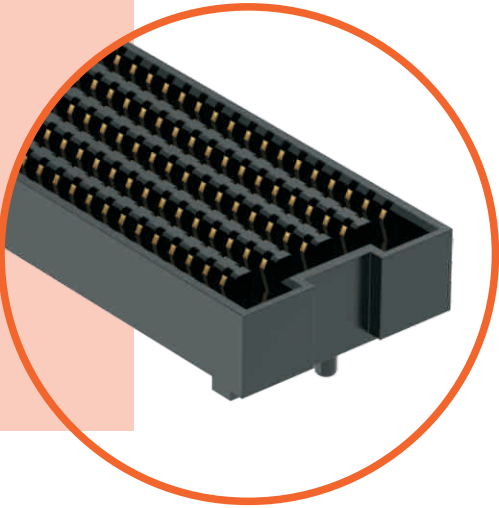
4、5、6、8、10、14排：40~700pin
配对合高：7.00~18.5mm

型号命名规则

WSEAM系列

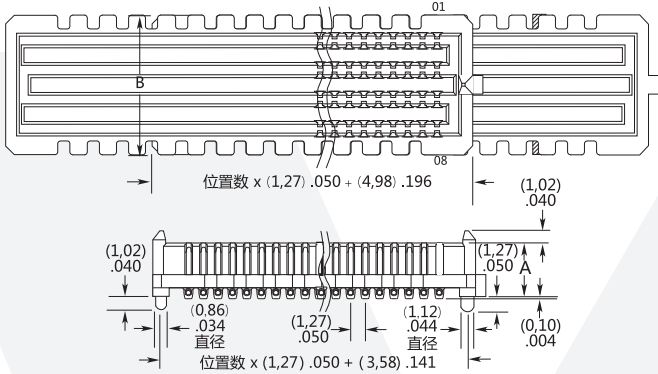


WSEAF系列



SERIES	排数	每排引脚数对数	引线式样	其他选项	A K TR
WSEAM =终端 WSEAF =插座	4, 5, 6, 8, 10, 14 (WSEAM4.5和6 行不适用于H06.5 引线样式)	10, 15, 19, 20, 30, 40, 50 WSEAM & WSEAF: 4行中仅有10个可用 WSEAM: 15只在4个中可用带有H02: 0引线样式的行, 并且10行, 带有任意引 线样式WSEAF: 15只在4个中可用或10行 带H5.0引线样式	从图表 中指定 引线式样	L =信号引脚和接地板上镀10μ" (0,25 μm)的金, 焊尾镀雾锡 S =信号引脚和接地板上镀30μ" (0,76 μm)的金, 焊尾镀雾锡 STL =信号引脚和接地板上镀30μ" (0,76 μm)的金, 焊尾镀雾锡或铅	A =对齐销 K =聚酰亚胺薄膜拾取和放置垫 TR =卷带封装

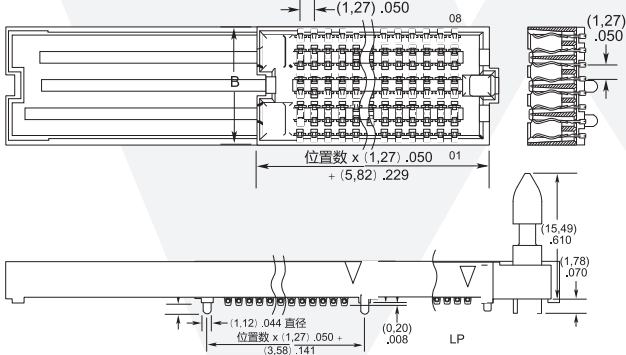
WSEAM



引线式样	A
H02.0	5.61
H03.0	6.60
H03.5	7.11
H06.5	10.16
H07.0	10.59
H09.0	12.60
H11.0	14.61

排数	B
4	7.06
5,6	9.60
8	12.14
10	14.68
14	17.22

WSEAF



引线式样	A	排数	B
H05.0	5.05	4	5.66
H06.0	6.05	5,6	8.20
H06.5	6.55	8	10.74
H07.5	7.54	10	13.28
		14	15.82

技术参数

绝缘体材料：黑色液晶聚合物
触点材料：铜合金
焊接：锡95.5% 银3.8% 铜0.7%
电镀：在50μ" (1.27μm)的镍上镀金或锡
工作温度范围：-55℃至+125℃
触点电阻：5.5 mΩ
工作电压：240 VAC
可无铅焊接：是

额定电流(每个触点)	
环境温度	WSEAM/WSEAF
20℃	2.3A
40℃	2A
60℃	1.75A
95℃	1.14A
为30个临近位置供电	

WSEAM 引线式样	WSEAF 引线式样			
	H05.0	H06.0	H06.5	H07.5
H02.0	7mm	8mm	8.5mm	9.5mm
H03.0	8mm	9mm	9.5mm	10.5mm
H03.5	8.5mm	9.5mm	10mm	11mm
H06.5	11.5mm	12.5mm	13mm	14mm
H07.0	12mm	13mm	13.5mm	14.5mm
H09.0	14mm	15mm	15.5mm	16.5mm
H11.0	16mm	17mm	17.5mm	18.5mm

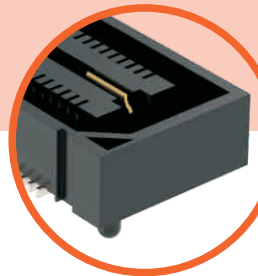
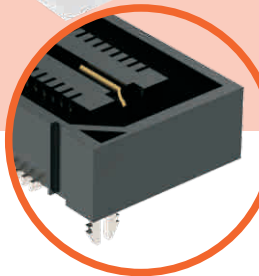
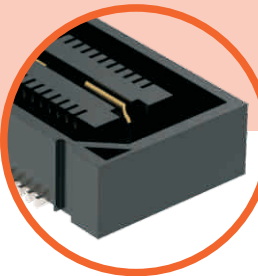
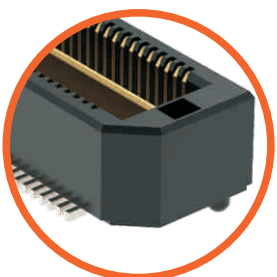
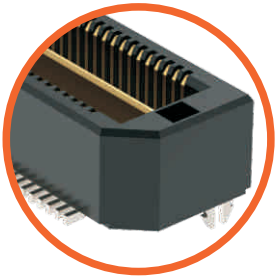
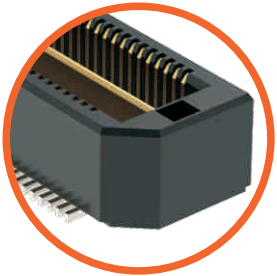
注：某些尺寸、式样和选项为非标准型，不可退换。

0.5mm 间距 WQTH / WQSH系列
两排：40~180pin 配对合高：5.00~25.00mm

型号命名规则

WQSH 系列

WQTH系列



技术参数

绝缘体材料：黑色液晶聚合物
端子材料：磷铜
电镀：在50μ" (1.27μm)的镍上镀金或镀锡
额定电流：
触点：1.0A每针@30℃温升 接地板：7.8A每个接地板@30℃温升
工作温度范围：-55℃至+125℃
额定电压：175 VAC (5 mm 堆叠高度)
最大配接次数：100
SMT引线共面度：
(0,10 mm) .004"最大(030-060)
(0,15 mm).006"最大(090)

注：某些尺寸、式样和选项为非标准型，不可退换。

WQTH	2	X	每排引脚数对数	引线式样	电镀选项	类型	A	选项	其他选项
------	---	---	---------	------	------	----	---	----	------

30, 60, 90
(每列总共 60 个引脚=D)

20, 40, 60
(每列20对=DDP)

从图表
中指定
引线式样

F
=信号引脚和接地板镀金膜，
焊尾镀锡

L
=信号引脚和接地板上镀
10μ" (0,25 μm)的金，焊
尾镀锡

C
=可选电镀在触点区域的
信号引脚上镀150μ"
(3,81 μm) 镍，之上镀
最少 50μ" (1,27 μm)
金、在触点区域的接地
板上镀 50μ" (1,27
μm) 镍，之上镀最少
10μ" (0,25 μm) 金，
在所有焊尾上镀最少
50μ" (1,27 μm) 镍，
之上镀锡

D
=单端

DDP
=差分对
(仅限H01)

K
=(7,00 mm)
.275" 直径的聚
酰亚胺膜取放垫

L
=锁扣选项(仅H01
铅样式)(在60
(DDP)和90上不
可用)

TR
=卷带封装

FR
=全卷带和卷
(每卷必须订货
最大数量，请联
系Worldpo)

引线式样	A	配接高度
H01	4.27	5.00
H02	7.26	8.00
H03	10.27	11.00
H04	15.25	16.00
H05	18.26	19.00
H07	24.24	25.00
H09	13.26	14.00

加工条件将影响配接高度。

WQSH	2	X	每排引脚数对数	H01	电镀选项	类型	A	选项	其他选项
------	---	---	---------	-----	------	----	---	----	------

30, 60, 90
(每列总共 60 个引脚=D)

20, 40, 60
(每列20对=DDP)

F
=信号引脚和接地板镀金膜，
焊尾镀锡

L
=信号引脚和接地板上镀
10μ" (0,25 μm)的金，焊
尾镀锡

C
=可选电镀在触点区域的信号
引脚上镀150μ"(3,81 μm)
镍，之上镀最少 50μ"
(1,27 μm) 金、在触点区
域的接地板上镀 50μ"
(1,27 μm) 镍，之上镀最
少 10μ" (0,25 μm) 金，
在所有焊尾上镀最少 50μ"
(1,27 μm) 镍，之上镀
锡

D
=单端

DDP
=差分对
(仅限H01)

K
=(7,00 mm)
.275" 直径的聚
酰亚胺膜取放垫

L
=锁扣选项(在60
(DDP)和90上不
可用)

TR
=卷带封装

FR
=全卷带和卷
(每卷必须订货
最大数量，请联
系Worldpo)

引线式样	A	配接高度
H01	4.27	5.00
H02	7.26	8.00
H03	10.27	11.00
H04	15.25	16.00
H05	18.26	19.00
H07	24.24	25.00
H09	13.26	14.00

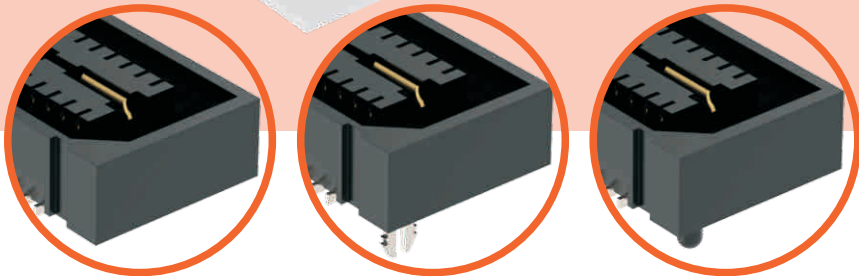
加工条件将影响配接高度。

0.80mm 间距 WQTE / WQSE系列

两排：28~120pin 配对合高：5.00~25.00mm

WQSE 系列

WQTE 系列



技术参数

绝缘体材料：黑色液晶聚合物

端子材料：磷铜

电镀：在50μ" (1.27μm)的镍上镀金或镀锡

额定电流：

触点：1.3A每针@周围环境95℃ 接地板：10.1A每个接地板@周围环境95℃

工作温度范围：-55℃至+125℃

额定电压：225 VAC (5 mm 堆叠高度)

最大配接次数：100

可无铅焊接：是

SMT引线共面度：(0,10 mm) .004"最大(020-060)

注：某些尺寸、式样和选项为非标准型，不可退换。

型号命名规则

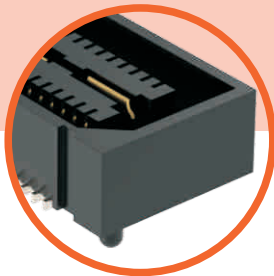
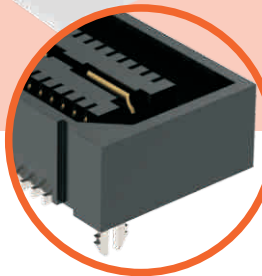
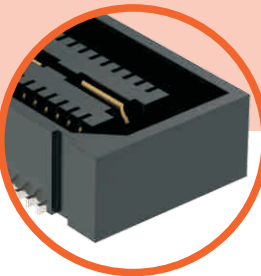
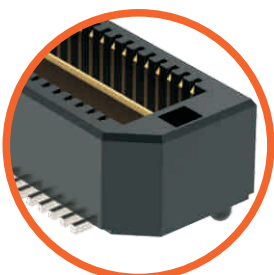
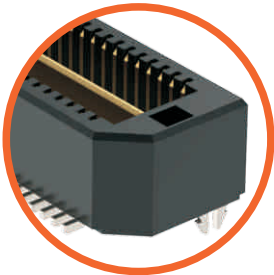
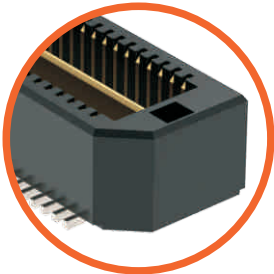
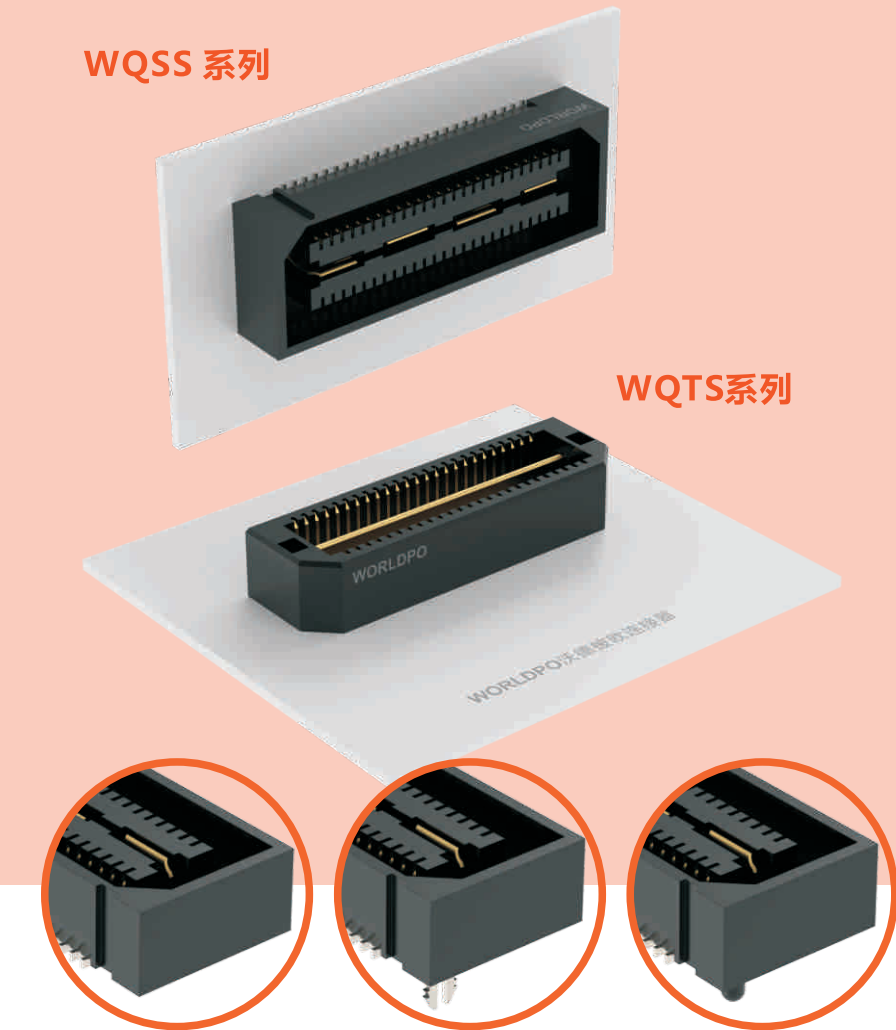
WQTE	2	X	每排引脚数对数	引线式样	电镀选项	类型	A	选项	其他选项																								
020, 040, 060 (每列总共 40 个引脚=D) 014, 028, 042 (每列14对=DDP)				从图表 中指定 引线式样	F =信号引脚和接地板镀金膜， 焊尾镀雾锡 L =信号引脚和接地板上镀 10μ" (0,25 μm)的金， 焊尾镀雾锡 C =可选电镀在触点区域的信 号引脚上镀150μ"(3,81 μm) 镍，之上镀最少 50μ"(1,27 μm) 金。在 触点区域的接地板上镀 50μ" (1,27 μm) 镍，之 上镀最少 10μ" (0,25 μm) 金，在所有焊尾上镀最少 50μ"(1,27 μm) 镍，之上 镀雾锡	D =单端 DDP =差分对 (仅限H01)		K =(7,00 mm) .275" 直径的聚 酰亚胺膜取放垫 L =闭锁选项 (无42&60位置)	TR =卷带封装 FR =全卷带和卷 (每卷必须订货 最大数量，请联 系Worldpo)																								
D-DP = (每排位置数 /14) x (20,00) .7875 D = (每排位置数 /20) x (20,00) .7875 (20,00) .7875 (5,97) .235 (7,11) .280 (0,80) .0315 (0,20) .008 A (0,76) .030 (0,89) .035 直径 (0,64) .025 L																																	
<table><thead><tr><th>引线式样</th><th>A</th><th>配接高度</th></tr></thead><tbody><tr><td>H01</td><td>4.27</td><td>5.00</td></tr><tr><td>H02</td><td>7.26</td><td>8.00</td></tr><tr><td>H03</td><td>10.27</td><td>11.00</td></tr><tr><td>H04</td><td>15.25</td><td>16.00</td></tr><tr><td>H05</td><td>18.26</td><td>19.00</td></tr><tr><td>H07</td><td>24.24</td><td>25.00</td></tr><tr><td>H09</td><td>13.26</td><td>14.00</td></tr></tbody></table> 加工条件将影响配接高度。										引线式样	A	配接高度	H01	4.27	5.00	H02	7.26	8.00	H03	10.27	11.00	H04	15.25	16.00	H05	18.26	19.00	H07	24.24	25.00	H09	13.26	14.00
引线式样	A	配接高度																															
H01	4.27	5.00																															
H02	7.26	8.00																															
H03	10.27	11.00																															
H04	15.25	16.00																															
H05	18.26	19.00																															
H07	24.24	25.00																															
H09	13.26	14.00																															

WQSE	2	X	每排引脚数对数	H01	电镀选项	类型	A	选项	其他选项
020, 040, 060 (每列总共 40 个引脚=D) 014, 028, 042 (每列14对=DDP)					F =信号引脚和接地板镀金膜， 焊尾镀雾锡 L =信号引脚和接地板上镀 10μ" (0,25 μm)的金， 焊尾镀雾锡 C =可选电镀在触点区域的信 号引脚上镀150μ"(3,81 μm) 镍，之上镀最少 50μ"(1,27 μm) 金。在 触点区域的接地板上镀 50μ" (1,27 μm) 镍，之 上镀最少 10μ" (0,25 μm) 金，在所有焊尾上镀最少 50μ"(1,27 μm) 镍，之上 镀雾锡	D =单端 DDP =差分对 (仅限H01)		K =(7,00 mm) .275" 直径的聚 酰亚胺膜取放垫 L =闭锁选项 (无42&60位置) GP =引导柱	TR =卷带封装 FR =锁定夹 (不提供A) (需要手动放置)
D-DP = (每排位置数 /14)x (20,00) .7875 + (1,27) .050 D = (每排位置数 /20) x (20,00) .7875 + (1,27) .050 (20,00) .7875 (7,24) .285 (7,49) .295 (0,80) .0315 (0,15) .006 (3,25) .128 (3,05) .120 (0,76) .030 (0,89) .035 直径 (0,64) .025 L									

0.635mm 间距 WQTS / WQSS系列

两排：50~150pin 配对合高：5.00~8.00mm

型号命名规则



WQTS	2	X	每排引脚数 对数	引线式样	电镀选项	A	选项	选项
------	---	---	-------------	------	------	---	----	----

025, 050, 075
(每列总共 50 个位置)

从图表中指定
引线式样

F
=信号引脚和接地板镀
金膜，焊尾镀锡

L
=信号引脚和接地板上
镀10μ" (0,25 μm)
的金，焊尾镀锡

K
=(7,00 mm)
.275" 直径的聚酰
亚胺膜取放垫

TR
=卷带封装

FR
=全卷带和卷
(每卷必须订货最
大数量，请联系
Worldpo)

C
=可选电镀在触点区域的信
号引脚上镀150μ" (3,81
μm) 镍，之上镀最少 50
μ" (1,27 μm) 金、在触
点区域的接地板上镀 50
μ" (1,27 μm) 镍，之上
镀最少 10μ" (0,25 μm)
金，在所有焊尾上镀最少
50μ" (1,27 μm) 镍，之
上镀锡

STL
=30μ"接触区有选择性金，
尾部有锡/铅

堆叠高度

引线式样	A	配接高度
H01	(4.27).168	(5.00).197
H02	(7.26).286	(8.00).315

加工条件将影响配接高度。

WQSS	2	X	每排引脚数 对数	H01	电镀选项	A	选项	选项
------	---	---	-------------	-----	------	---	----	----

025, 050, 075
(每列总共 50 个位置)

F
=信号引脚和接地板镀
金膜，焊尾镀锡

L
=信号引脚和接地板上
镀10μ" (0,25 μm)
的金，焊尾镀锡

GP
=穿孔，与 WQTS RA
配接

K
=(8.25 mm).325"
直径的聚酰亚胺膜
取放垫

TR
=卷带封装

FR
=全卷带和卷
(每卷必须订货最
大数量，请联系
Worldpo)

C
=可选电镀在触点区域的信
号引脚上镀150μ" (3,81
μm) 镍，之上镀最少 50
μ" (1,27 μm) 金、在触
点区域的接地板上镀 50
μ" (1,27 μm) 镍，之上
镀最少 10μ" (0,25 μm)
金，在所有焊尾上镀最少
50μ" (1,27 μm) 镍，之
上镀锡

STL
=30μ"接触区有选择性金，
尾部有锡/铅

技术参数

绝缘体材料：黑色液晶聚合物

触点材料：磷铜

电镀：在50μ" (1.27μm)的镍上镀金或镀锡

额定电流：

触点：1.1A每针@30°C温升 接地板：7.8A每个接地板@30°C温升

工作温度范围：-55°C至+125°C

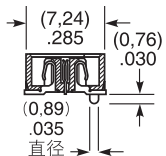
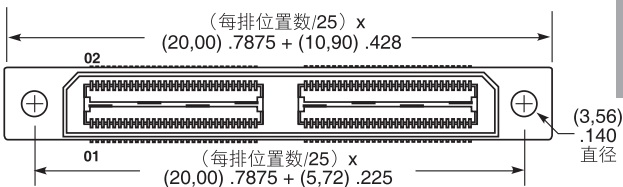
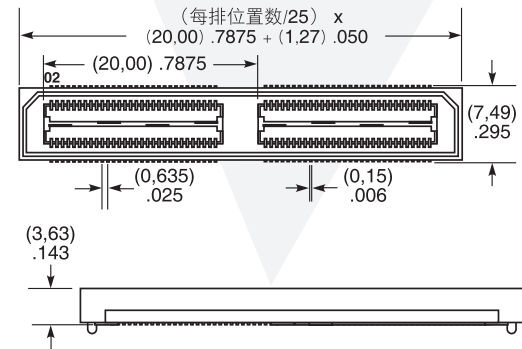
额定电压：285 VAC

最大配接次数：100

可无铅焊接：是

SMT引线共面性：(0,10 mm) .004"最大(025-075)

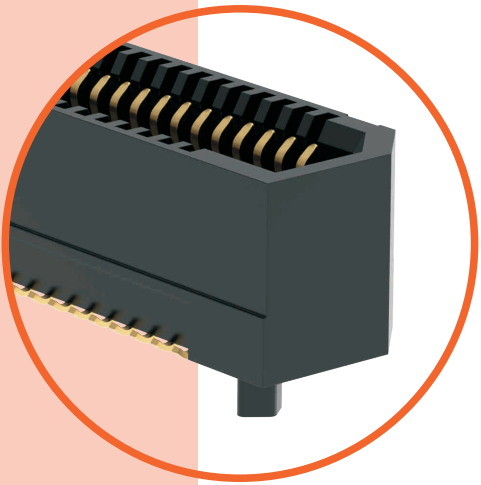
注：某些尺寸、式样和选项为非标准型，不可退换。



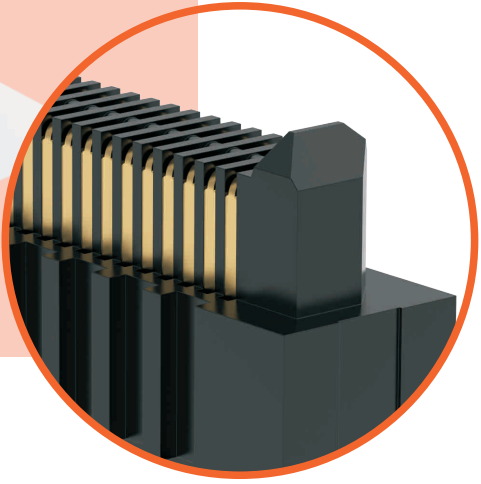
0.80mm 间距 WERM8 / WERF8系列

两排：10~200pin 配对合高：7.00~18.00mm

WERF8 系列



WERM8 系列



技术参数

绝缘体材料：黑色液晶聚合物
触点材料：镀铜
端子材料：磷铜
锁扣材料：镀铜
电镀：在50μ" (1.27μm)的镍上镀金或镀锡
额定电流：1.4A每针@周围环境95℃（6个邻近的通电针脚）
工作温度范围：-55℃至+125℃
额定电压 (WERM8-RA)：最大235 VAC
额定电压 (WERM8-EM)：最大200 VAC
可无铅焊接：是

SMT 引线共面度：
最大(0,10 mm) .004"
SMT 引线共面度：
最大(0,10 mm) .004" (005-030)
最大 (0,12 mm) .005" (040-075)

注：某些尺寸、式样和选项为非标准型，不可退换。

型号命名规则

系列	2 X	每排引脚数	引线式样	电镀选项	DV	选项	选项
WERM8 WERF8		05, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 49, 50, 60, 70, 75, 100	从图表中 指定 引线式样	L =触点镀 10μ" (0,25 μm) 的金， 焊尾镀雾锡 S =触点上 镀 30μ" (0,76 μm) 的金，焊尾镀金膜		DS =差分对(WERM8 H05.0铅型，仅有 10,13, 25, 49个 位置)(P不可用) L =锁定(仅WERM8 H03.0,H05.0& H09.0Lead样式 &图形不可用)(仅 WERF8 H05.0, H07.0&H09.0 Lead样式,L&EGP 选项不可用) EGP =扩展式导柱(不适用于-L选项) DSP =带延长导柱的差分 对(WERM8+05.0 铅型，仅有13和25 个位置) K =麦拉片 (6,00 mm).236" 直径聚酰亚胺薄膜 取放垫 P =挑垫 (仅WERM8 H02.0, H03.0& H05.0 铅样式)(DS不可用)	TR =卷带封装 FR =全卷带和卷 (每卷必须订 货最大数量， 请联系 Worldpo)

WERM8

WERM8 引线式样	A	B
H02.0	5.97	5.97
H03.0	6.97	1.60
H05.0	8.91	1.17
H08.0	11.91	N/A
H09.0	12.91	1.60

WERF8

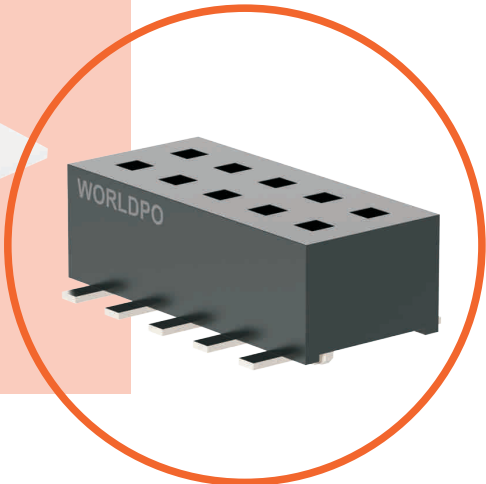
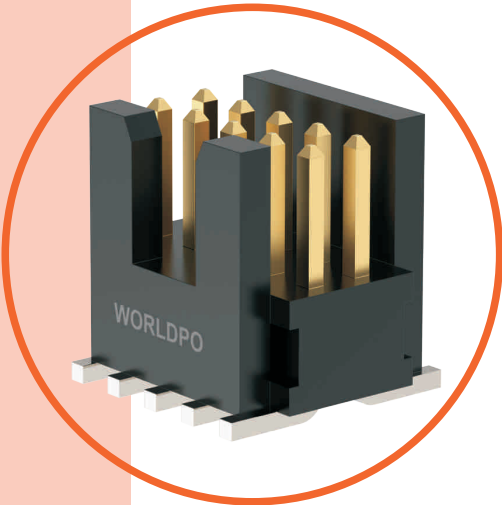
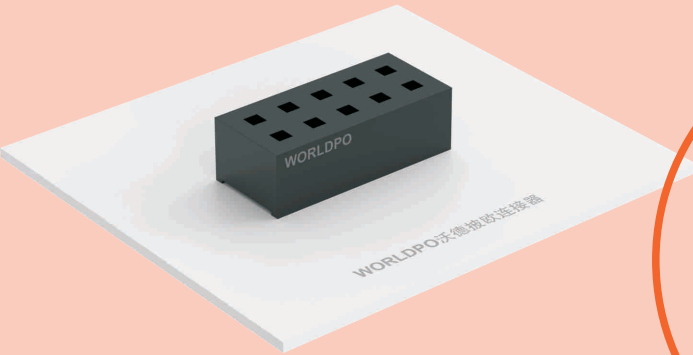
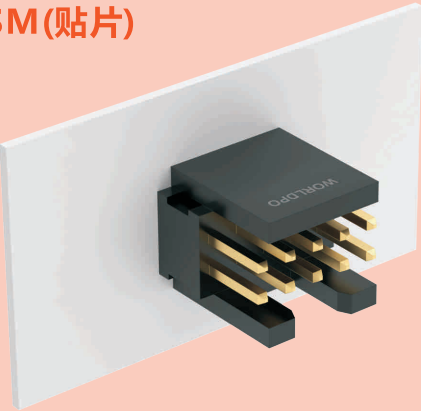
WERF8 引线式样	C	D
H05.0	5.34	1.60
H07.0	7.25	1.17
H09.0	9.34	1.60

配接高度			
WERM8 引线式样	WERF8 引线式样		
	H05.0	H07.0	H09.0
H02.0	7.00	9.00	11.00
H03.0	8.00	10.00	12.00
H05.0	10.00	12.00	14.00
H08.0	13.00	15.00	17.00
H09.0	14.00	16.00	18.00

1.27mm 间距 WFTSH系列

两排：4~100pin

WFTSH-SM(贴片)



技术参数

绝缘体材料：黑色液晶聚合物
端子材料：磷铜
电镀：在50μ" (1.27μm)的镍上镀金或镀锡
额定电流：每引脚3.4A (2引脚供电)
工作温度范围：-55℃至+125℃
可无铅焊接：是
SMT引线共面度：
MT 与 DV 焊尾选择：
(0,10 mm) .004" 最大 (02-25)
MT 与 DH 焊尾选择：
(0,15 mm) .006" 最大 (26-50)

型号命名规则

WFTSH	2	每排 引脚数	引线式样	电镀选项	焊尾选择	选项	柔性围墙 选择	其他选项
WFTSH-SM (贴片)		02 至 50	H01 =(3.05 mm) .120"接线柱 H02 =(1.91 mm) .075"接线柱 H03 =(1.65 mm) .065"接线柱 H04 =(3.81 mm) .150"接线柱 H05 =(4.32 mm) .170"接线柱	F =接线柱镀 金膜，焊 尾镀锡 L =接线柱镀 10μ"(0.25 μm)的金， 焊尾镀锡	DV =双垂直 DH =双水平 (仅限式样 H01、H02、 和H04) MT =混合技术 (仅限式样 H01、H02、 和H04)	留空以DH 和MT "XXX" =偏振位置 (指定省略引 脚的位置) (EX选项不 可用)	(仅限式样 H02和H03， 不提供DH和 MT)每排最 小引脚数9 ES =端头围墙 EC =带有锁定夹 的端头围墙(需 要手动放置) EP =带有导柱的 端头围墙 EL =带有板锁的 端头围墙(板 被牢固地锁 住，无法拔出) EJ =(仅限式样 H01)不提供 DH 和MT每 排最小引脚数10 每排最大引脚 数 25	K =带键槽围墙 (仅与FFSD 式 样H01配接， 仅限 05、08、 10、13、17、 20和25个引 脚/每排，13、 17、20和25 仅用于带围墙) (仅限-DV) A =定位针(DV 最小3个位置) DH最小5个 位置) C =(4.00 mm) .157"直径的 聚酰亚胺膜取 放垫(仅限DH) P =取放垫(DV 最小4个位置) (不提供DH 和MT) TR =卷带封装(除 ES和-EJ外， 不提供柔性围 墙选择) FR =全卷带和卷 (每卷必须订 货最大数量， 请联系 Worldpo)

EX选项

DH

EJ选项

MT

DV

ES

EP

K

EC

EL

EJ

P

A

引线 式样	A
H01	3.05
H02	1.91
H03	1.65
H04	3.81
H05	4.32

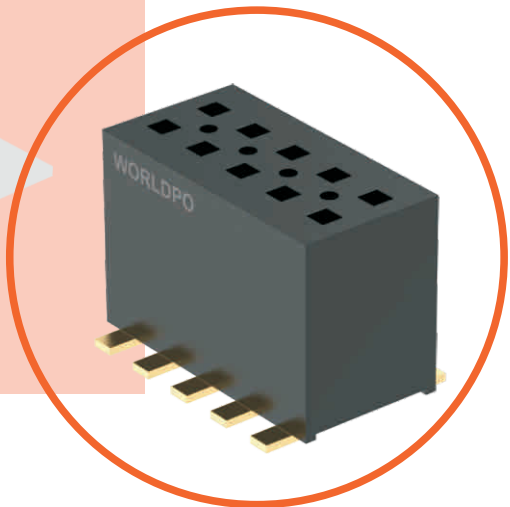
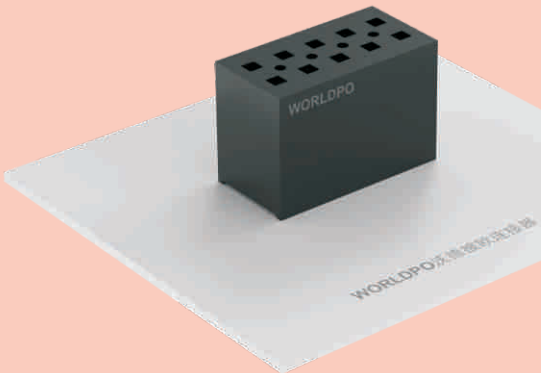
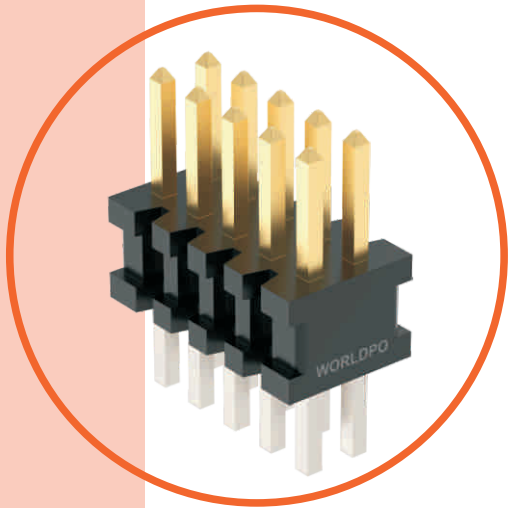
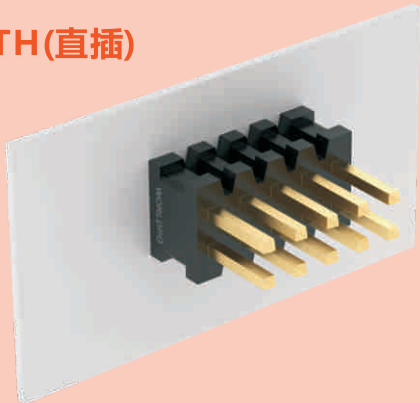
注：某些尺寸、式样和选项为非标准型，不可退换。

1.27mm 间距 WFTSH系列

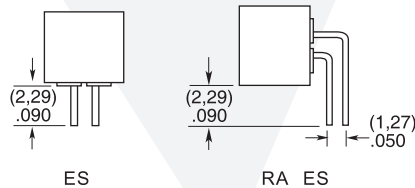
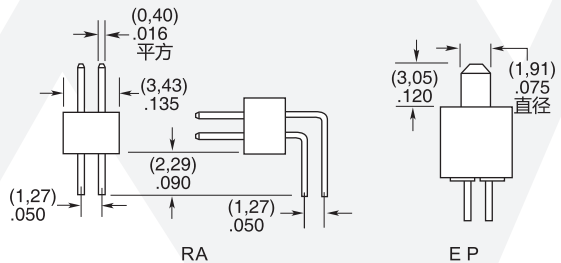
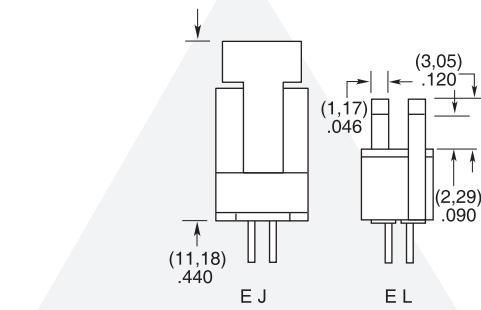
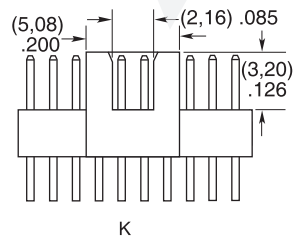
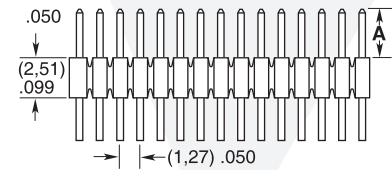
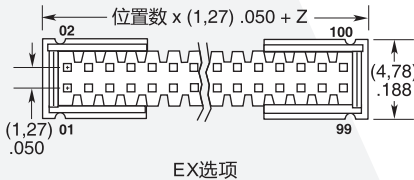
两排：4~100pin

型号命名规则

WFTSH-TH(直插)



WFTSH	2	每排 引脚数	引线式样	电镀选项	D	选项	焊尾选择	其他选项
WFTSH-TH (直插)		02 至 50	从图中指定 引线式样	F =接线柱镀 金膜，焊 尾镀雾锡 L =接线柱镀 10μ"(0.25 μm)的金， 焊尾镀雾锡		留空用于直角 "XXX" =偏振位置 (指定省略引 脚的位置) (EX选项不 可用)	若为直式焊尾， 则保留空白 RA =弯角	ES =端头围墙 (式样H02和H03) 每排最小引脚数9 EP =带有导柱的 端头围墙 (式样H02和H03) 每排最小引脚数9 EL =带板锁的端 头围墙 (式样H02和H03) 每排最小引脚数9 EJ =弹出器围墙 (仅限式样H01) 每排最小引脚数10 每排最小引脚数25 不提供RA K =带键槽围墙 (仅与FFSD式样 H01配接，仅限 05-25个引脚/每 排和13、17、20 和25仅用于带围墙)



引线式样	A
H01	(3.05).120
H02	(1.91).075
H03	(1.65).065
H04	(3.81).150

选项	Z
ES	(1.55).061
EJ	(15.77).621
EP	(5.87).231
EL	(6.53).257

技术参数

绝缘体材料：黑色液晶聚合物
端子材料：磷铜
电镀：在50μ" (1.27μm)的镍上镀金或镀锡
额定电流：每引脚3.4A (2引脚供电)
工作温度范围：-55℃至+125℃
可无铅焊接：是

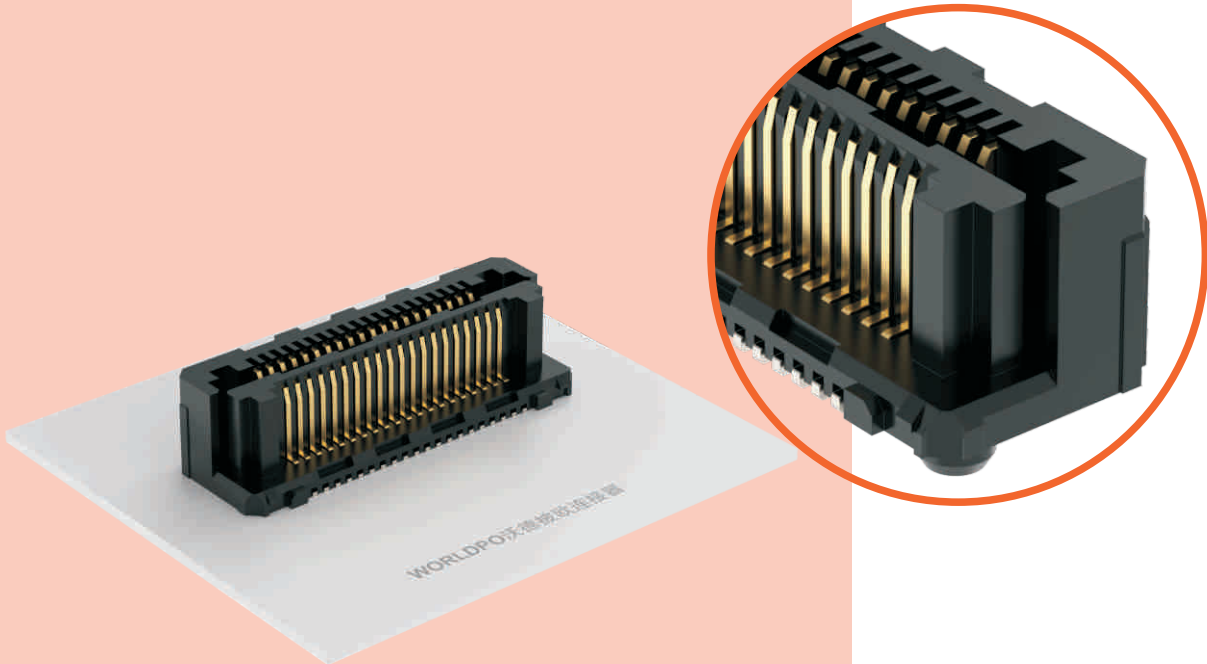
注：某些尺寸、式样和选项为非标准型，不可退换。

0.50mm 间距 WLSHM系列

两排：10~100pin 配对合高：5.00~12.00mm

型号命名规则

WLSHM系列



WLSHM	2	每排 引脚数	引线 式样	电镀选项	焊尾选择	A	屏蔽选择	K	"X"R
-------	---	-----------	----------	------	------	---	------	---	------

05, 10, 20
30, 40, 50

从图表中
指定引线
式样
(直角)
H01
=标准
(直角)
HL1
=润滑

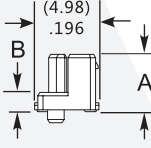
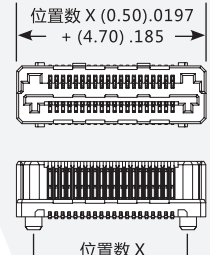
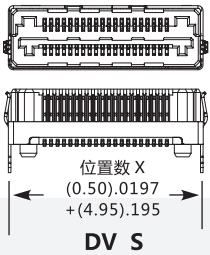
F
=接线柱镀金
膜，焊尾镀
雾锡
L
=接线柱镀
10μ"(0.25
μm)的金，
焊尾镀雾锡

DV
=垂直
DH
=直角
(仅限H01
和HL1)
RH
=反向直角
(仅限H01
和HL1)

S
=有屏蔽
N
=无屏蔽

K
=(3.50 μm)
直径0.138
英寸，焊尾
镀雾锡

TR
=卷带封装
FR
=全卷带和卷
(每卷必须订货
最大数量，请
联系
Worldpo)



引线式样	引线式样	A	B
H02.5	HL2.5	(3.95).156	(1.00).039
H03.0	HL3.0	(4.45).175	(1.50).059
H04.0	HL4.0	(5.45).215	(2.50).098
H06.0	HL6.0	(7.45).293	(4.50).177

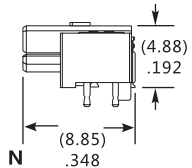
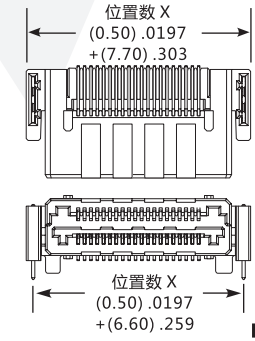
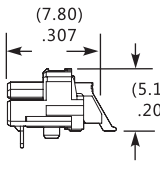
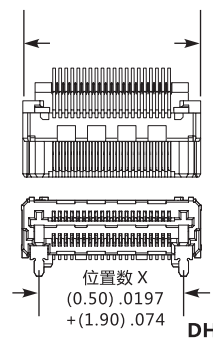
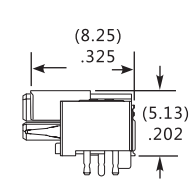
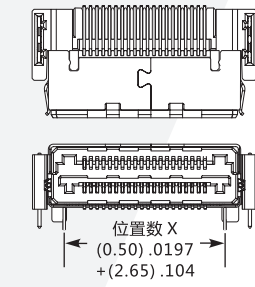
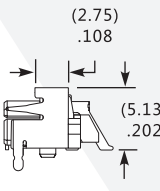
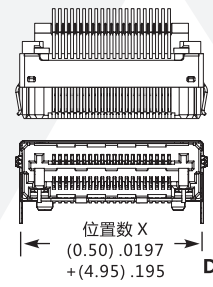
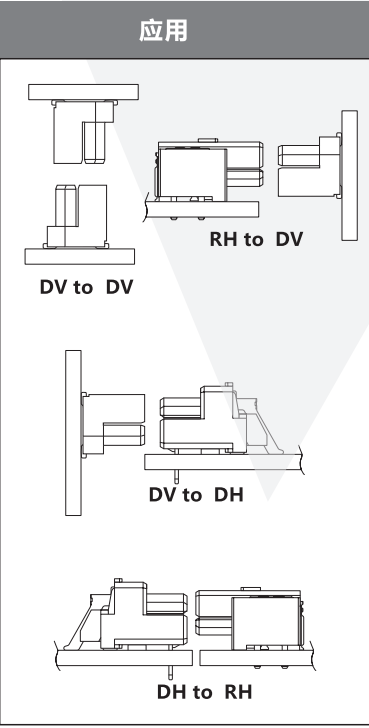
引线式样	配接高度
H02.5 & H02.5	(5.00).196
H02.5 & H03.0	(5.50).217
H03.0 & H03.0	(6.00).236
H02.5 & H04.0	(6.50).256
H03.0 & H04.0	(7.00).276
H04.0 & H04.0	(8.00).315
H02.5 & H06.0	(8.50).335
H03.0 & H06.0	(9.00).354
H04.0 & H06.0	(10.00).394
H02.5 & H03.0	(12.00).472

加工条件将影响配接高度。

技术参数

绝缘体材料：黑色液晶聚合物
触点材料：磷铜
电镀：在50μ" (1.27μm)的镍上镀金或镀锡
额定电流：
触点：1.3A每针@周围环境95℃ (6个通电位置)
工作温度范围：-55℃至+125℃
可无铅焊接：是
SMT引线共面度：最大(0,10 mm) .004"

注：某些尺寸、式样和选项为非标准型，不可退换。



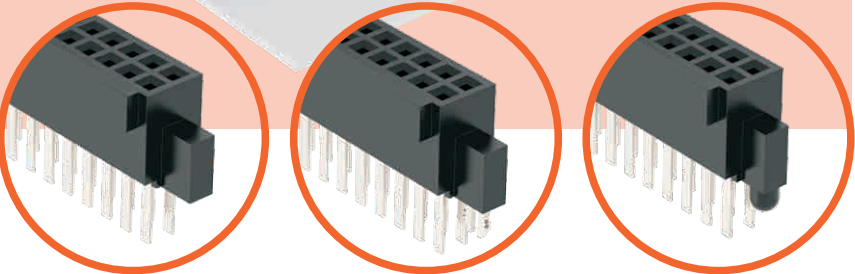
1.27mm 间距 WSFC / WTFC系列

两排：6~100pin
配对合高：贴片：6.35~11.81mm
直插：5.97~11.43mm

WSFC系列



WTFC系列



技术参数

绝缘体材料：黑色液晶聚合物
触点材料：磷铜
电镀：在50μ" (1.27μm)的镍上镀金或锡
额定电流：2A每针@周围环境80℃
额定电压：350 VAC(与 WTFC 配接时)
工作温度范围：-55℃至+125℃
触点电阻：15 mΩ
插入深度：
(3,05 mm) .120"至(4,06 mm) .160"

插入力 (WSFM)：(仅单触点)
平均为 2.5 盎司 (0,69 N)
拔出力 (WSFM)：(仅单触点)
平均为 2.0 盎司 (0,56 N)
最大插拔次数：10,000 次
(具有 30μ" (0,76 μm)镀金)
可无铅焊接：是
SMT引线共面度：
最大(0,10 mm) .004"(10-25)
最大(0,15 mm) .006"(30-50)

额定电流(每个触点)	
环境温度	WTFC/WSFC
20℃	3.7A
40℃	3.4A
60℃	2.9A
95℃	1.9A
6 个通电位置(2x3)	

注：某些尺寸、式样和选项为非标准型，不可退换。

型号命名规则

WSFC	2	每排引脚数	引线式样	电镀选项	D	选项
		04, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 (标准尺寸)	HT1 =穿孔 HT2 =表面贴装	F =触点镀金膜， 焊尾镀雾锡 L =在触点上 镀10μ"(0,25 μm) 的金，焊尾镀雾锡		A =定位针 LC =锁定夹 K =(4,00 mm).175" 直径的聚酰 亚胺膜取放垫 TR =卷带封装 FR =全卷轴胶带&卷轴(仅限HT2号)

WTFC	2	每排引脚数	引线式样	电镀选项	D	选项
		03, 04, 06, 08 (仅限H01, H02) 05, 07, 10, 15	H01 =穿孔 H02 =表面贴装	F =接线柱镀金膜， 焊尾镀雾锡 L =接线柱上镀10μ" (0,25 μm)的金， 焊尾镀雾锡		RA =直角(仅限H01) A =定位针 LC =锁定夹 (需要手工放置)(RA不提供) K =(4,00 mm).175" 直径的聚 酰亚胺膜取放垫 P =塑料拣选和放置垫(5个位置 最少)(不适用于RA) TR =卷带封装 FR =全卷轴胶带&卷轴 (仅限HT2号)

SMT 引线式样	A	B
H02	(5.72).225	(3.38).133
H12	(7.49).295	
H22	(9.27).365	(3.30).130
H32	(11.18).440	

TH 引线式样	A	B
H01	(5.59).220	(3.38).133
H11	(7.37).290	
H21	(9.14).360	(3.30).130
H31	(11.05).435	